

2018-2023年中国集成电路行业市场需求现状分析及投资方向评估分析报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国集成电路行业市场需求现状分析及投资方向评估分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/309280309280.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

观研天下发布的《2018-2023年中国集成电路行业市场需求现状分析及投资方向评估分析报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及有关部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是为了了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章：中国集成电路行业发展分析

1.1 集成电路行业发展综述

1.1.1 集成电路行业统计标准

1.1.2 集成电路行业周期性

1.1.3 集成电路行业产业链简介

1.1.4 集成电路行业材料供给分析

（1）国际硅材料供应现状

（2）国内集成电路生产材料供应现状

1.1.5 集成电路生产设备供给分析

（1）国内电子工业专用设备制造业运行情况

（2）国内集成电路装备制造业状况分析

1.1.6 集成电路行业发展环境分析

（1）集成电路行业政策环境分析

（2）集成电路行业经济环境分析

（3）集成电路行业技术环境分析

（4）集成电路行业进出口环境分析

1.2 集成电路行业发展现状分析

1.2.1 全球集成电路行业发展现状

（1）行业需求稳健成长

（2）全球半导体资本开支开始下降，订单出货比稳定

1.2.2 中国集成电路行业发展现状分析

- (1) 行业经济指标分析
- (2) 行业结构分析
- (3) 行业总体技术水平分析
- (4) 行业总体竞争力分析
- 1.2.3 集成电路行业区域发展格局分析
 - (1) 国内集成电路行业区域发展现状
 - (2) 国内集成电路行业整体分布格局
- 1.2.4 集成电路产业面临的发展机遇
- 1.2.5 集成电路行业面临的主要问题
 - (1) 对进口产品仍有较大依赖性
 - (2) 技术能力不强
 - (3) 在产业格局中处于边缘
- 1.3 集成电路设计业发展分析
 - 1.3.1 集成电路设计业发展概况分析
 - 1.3.2 集成电路设计业市场规模分析
 - 1.3.3 集成电路设计业市场特征分析
 - (1) 技术能力大幅提升
 - (2) 行业发展仍存隐忧
 - 1.3.4 集成电路设计业竞争格局分析
 - 1.3.5 集成电路设计业发展策略分析
 - 1.3.6 集成电路设计业发展前景预测
- 1.4 集成电路制造行业发展分析
 - 1.4.1 集成电路制造行业发展现状分析
 - (1) 集成电路制造行业发展总体概况
 - (2) 集成电路制造行业发展主要特点
 - (3) 集成电路制造行业规模及财务指标分析
 - 1.4.2 集成电路制造行业经济指标分析
 - (1) 集成电路制造行业主要经济效益影响因素
 - (2) 集成电路制造行业经济指标分析
 - 1.4.3 集成电路制造行业供需平衡分析
 - (1) 集成电路制造行业供给情况分析
 - (2) 集成电路制造行业需求情况分析
 - (3) 全国集成电路制造行业产销率分析
 - 1.4.4 集成电路制造行业发展前景预测
- 1.5 集成电路封装测试业发展分析

- 1.5.1 集成电路封测业市场规模分析
- 1.5.2 集成电路封测业经营情况分析
- 1.5.3 国内外厂商技术水平对比分析
- 1.5.4 集成电路封测业竞争格局分析
 - (1) 国内集成电路封测业竞争格局分析
 - (2) 国内集成电路封测企业国际竞争力分析
 - (3) 集成电路封装测试业竞争结构波特五力模型分析
- 1.5.5 集成电路封测业发展趋势分析
 - (1) 封装技术发展趋势
 - (2) 应用领域发展趋势
- 1.5.6 集成电路封测业发展前景预测

第二章：中国集成电路细分产品市场需求分析

- 2.1 IC卡市场需求分析
 - 2.1.1 IC卡市场需求现状分析
 - 2.1.2 IC卡市场需求规模分析
 - 2.1.3 IC卡市场竞争格局分析
 - (1) 市场占有率分析
 - (2) 各企业竞争优势分析
 - 2.1.4 IC卡市场需求前景预测
- 2.2 计算机市场需求分析
 - 2.2.1 计算机市场需求现状分析
 - 2.2.2 计算机市场供给规模分析
 - 2.2.3 计算机市场需求规模分析
 - 2.2.4 计算机市场经营效益分析
 - 2.2.5 计算机市场竞争格局分析
 - (1) 整体竞争格局分析
 - (2) 重点企业竞争格局分析
 - 2.2.6 计算机市场发展趋势预测
 - (1) PC市场结构调整，用户数量将下降
 - (2) 智能化趋势提供新的机遇
 - (3) 游戏本发展迅猛
 - (4) 国产化替代浪潮加速
- 2.3 无线通信设备市场需求分析
 - 2.3.1 无线通信设备市场需求现状分析

2.3.2 无线通信设备市场供给规模分析

2.3.3 无线通信设备市场需求规模分析

2.3.4 无线通信设备市场竞争格局分析

2.3.5 无线通信设备市场需求前景预测

(1) 全球市场预测

(2) 国内市场预测

2.4 其他消费类电子产品市场需求分析

2.4.1 其他消费类电子产品需求现状分析

2.4.2 其他消费类电子产品需求规模分析

2.4.3 其他消费类电子产品竞争格局分析

(1) 数码相机竞争格局分析

(2) 平板电视竞争格局分析

(3) 智能穿戴设备竞争格局分析

2.5 微控制单元 (MCU) 市场需求分析

2.5.1 MCU市场需求现状分析

2.5.2 MCU市场需求规模分析

2.5.3 MCU市场竞争格局分析

(1) MCU市场整体竞争格局

(2) MCU细分市场竞争格局

2.5.4 MCU市场需求前景预测

第三章：中国集成电路芯片市场需求分析

3.1 SIM芯片市场需求分析

3.1.1 SIM芯片发展现状分析

3.1.2 SIM芯片需求规模分析

3.1.3 SIM芯片竞争格局分析

3.1.4 SIM芯片需求前景预测

3.2 移动支付芯片市场需求分析

3.2.1 移动支付芯片发展现状分析

(1) 移动支付产品分析

(2) 银联与中移动移动支付标准之争已经解决

(3) 已有大量POS机支持NFC功能

(4) 国内供应商开始发力NFC芯片

3.2.2 移动支付芯片需求规模分析

3.2.3 移动支付芯片竞争格局分析

- 3.2.4 移动支付芯片需求前景预测
- 3.3 身份识别类芯片市场需求分析
 - 3.3.1 身份识别类芯片发展现状分析
 - (1) 身份识别介绍
 - (2) 身份识别分类
 - 3.3.2 身份识别类芯片需求规模分析
 - 3.3.3 身份识别类芯片竞争格局分析
 - (1) 国内厂商产能扩大
 - (2) 缺乏自主知识产权
 - (3) 安全性尚待加强
 - (4) 应用尚待开发
 - (5) 解决方案仍在探索
 - (6) 上游产能不足
 - 3.3.4 身份识别类芯片需求前景预测
- 3.4 金融支付类芯片市场需求分析
 - 3.4.1 金融支付类芯片发展现状分析
 - 3.4.2 金融支付类芯片需求规模分析
 - 3.4.3 金融支付类芯片竞争格局分析
 - 3.4.4 金融支付类芯片需求前景预测
- 3.5 USB-KEY芯片市场需求分析
 - 3.5.1 USB-KEY芯片发展现状分析
 - 3.5.2 USB-KEY芯片需求规模分析
 - 3.5.3 USB-KEY芯片竞争格局分析
 - 3.5.4 USB-KEY芯片需求前景预测
- 3.6 通讯射频芯片市场需求分析
 - 3.6.1 通讯射频芯片发展现状分析
 - 3.6.2 通讯射频芯片需求规模分析
 - 3.6.3 通讯射频芯片竞争格局分析
 - 3.6.4 通讯射频芯片需求前景预测
- 3.7 通讯基带芯片市场需求分析
 - 3.7.1 通讯基带发展现状分析
 - 3.7.2 通讯基带芯片需求规模分析
 - 3.7.3 通讯基带芯片竞争格局分析
 - (1) 国际厂商竞争格局分析
 - (2) 国内厂商竞争格局分析

3.7.4 通讯基带芯片需求前景预测

- (1) 基带和应用处理器融合加深
- (2) 价格战将加剧
- (3) 工艺决定竞争力

3.8 家电控制芯片市场需求分析

3.8.1 家电控制芯片发展现状分析

3.8.2 家电控制芯片需求规模分析

3.8.3 家电控制芯片竞争格局分析

3.8.4 家电控制芯片需求前景预测

3.9 节能应用类芯片市场需求分析

3.9.1 节能应用类芯片发展现状分析

3.9.2 节能应用类芯片需求规模分析

3.9.3 节能应用类芯片竞争格局分析

3.9.4 节能应用类芯片需求前景预测

3.10 电脑数码类芯片市场需求分析

3.10.1 电脑数码类芯片发展现状分析

3.10.2 电脑数码类芯片需求规模分析

3.10.3 电脑数码类芯片竞争格局分析

3.10.4 电脑数码类芯片需求前景预测

第四章：中国集成电路下游市场需求分析

4.1 计算机行业对集成电路需求分析

4.1.1 计算机行业发展现状分析

- (1) 计算机行业产值规模
- (2) 计算机行业外贸出口
- (3) 计算机行业投资情况分析

4.1.2 计算机对集成电路需求分析

4.2 智能手机行业对集成电路需求分析

4.2.1 智能手机行业发展现状分析

4.2.2 智能手机对集成电路需求现状

4.3 可穿戴设备行业对集成电路需求分析

4.3.1 可穿戴设备行业发展现状分析

4.3.2 可穿戴设备行业对集成电路需求分析

4.4 工业控制行业对集成电路需求分析

4.4.1 工业控制行业发展现状分析

- (1) 工业机器人发展现状
 - (2) 变频器发展现状
 - (3) 传感器发展现状
 - (4) 工控机发展现状
 - (5) 机器视觉发展现状
 - (6) 3D打印发展现状
 - (7) 运动控制器发展现状
- 4.4.2 工业控制对集成电路需求现状
 - 4.5 汽车电子行业对集成电路需求分析
 - 4.5.1 汽车电子行业发展现状分析
 - 4.5.2 汽车电子对集成电路需求现状
 - 4.5.3 汽车电子对集成电路需求前景

第五章：主要集成电路行业竞争主体发展分析

- 5.1 外商独资企业发展分析
 - 5.1.1 外商独资企业发展现状分析
 - 5.1.2 外商独资企业市场份额分析
 - 5.1.3 外商独资企业经营情况分析
 - 5.1.4 外商独资企业投资并购分析
 - 5.1.5 外商独资企业发展战略分析
 - 5.1.6 外商独资企业竞争优势分析
 - 5.1.7 前瞻对外商独资企业发展建议
- 5.2 中外合资企业发展分析
 - 5.2.1 中外合资企业发展现状分析
 - 5.2.2 中外合资企业市场份额分析
 - 5.2.3 中外合资企业经营情况分析
 - 5.2.4 中外合资企业投资并购分析
 - 5.2.5 中外合资企业发展战略分析
 - 5.2.6 中外合资企业竞争优势分析
 - 5.2.7 中外合资企业存在问题分析
 - 5.2.8 中外合资企业最新动向分析
 - 5.2.9 前瞻对中外合资企业发展建议
- 5.3 内资企业发展分析
 - 5.3.1 内资企业发展现状分析
 - 5.3.2 内资企业市场份额分析

- 5.3.3 内资企业经营情况分析
- 5.3.4 内资企业扶持政策分析
- 5.3.5 内资企业投资并购分析
- 5.3.6 内资企业发展战略分析
- 5.3.7 内资企业竞争优势分析
- 5.3.8 内资企业存在问题分析
- 5.3.9 内资企业最新动向分析
- 5.3.10 国内市场进口替代空间分析
- 5.3.11 前瞻对内资企业发展建议

第六章：重点区域集成电路产业发展分析

- 6.1 长三角地区集成电路产业发展分析
 - 6.1.1 集成电路产业发展概况
 - 6.1.2 集成电路产业政策规划分析
 - 6.1.3 集成电路设计业发展分析
 - 6.1.4 集成电路制造业发展分析
 - 6.1.5 集成电路封装测试业发展分析
 - 6.1.6 集成电路产业发展前景预测
- 6.2 京津环渤海地区集成电路产业发展分析
 - 6.2.1 集成电路产业发展概况
 - 6.2.2 集成电路产业政策规划分析
 - 6.2.3 集成电路设计业发展分析
 - 6.2.4 集成电路制造业发展分析
 - 6.2.5 集成电路封装测试业发展分析
 - 6.2.6 集成电路产业发展前景预测
- 6.3 泛珠三角地区集成电路产业发展分析
 - 6.3.1 集成电路产业发展概况
 - 6.3.2 集成电路产业政策规划分析
 - 6.3.3 集成电路产业配套发展分析
 - 6.3.4 集成电路设计业发展分析
 - 6.3.5 集成电路制造业发展分析
 - 6.3.6 集成电路封装测试业发展分析
 - 6.3.7 集成电路产业发展前景预测
- 6.4 其他重点地区集成电路产业发展分析
 - 6.4.1 重庆市集成电路产业发展分析

6.4.2 四川省集成电路产业发展分析

6.4.3 西安市集成电路产业发展分析

6.4.4 湖北省集成电路产业发展分析

第七章：集成电路领先企业发展分析

7.1 集成电路综合型企业发展分析

7.1.1 武汉光迅科技股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业组织架构分析
- (4) 企业产品结构分析
- (5) 企业目标市场分析
- (6) 企业营销网络分析
- (7) 企业新产品动向分析
- (8) 企业技术水平分析
- (9) 企业核心竞争力分析
- (10) 企业发展优劣势分析
- (11) 企业最新发展动向

7.1.2 大唐电信科技股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业组织与结构分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.1.3 恒宝股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业技术水平分析

(7) 企业核心竞争力分析

(8) 企业发展优劣势分析

(9) 企业最新发展动向

7.1.4 杭州士兰微电子股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

(7) 企业技术水平分析

(8) 企业核心竞争力分析

(9) 企业发展优劣势分析

(10) 企业最新发展动向

7.1.5 国民技术股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

(7) 企业技术水平分析

(8) 企业发展优劣势分析

(9) 企业最新发展动向

7.1.6 珠海欧比特控制工程股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

(7) 企业技术水平分析

(8) 企业发展优劣势分析

(9) 企业最新发展动向

7.1.7 同方国芯电子股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.1.8 无锡华润微电子有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.1.9 中国电子信息产业集团有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业技术水平分析
- (6) 企业发展优劣势分析

7.1.10 飞思卡尔半导体(中国)有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向

7.2 集成电路设计企业发展分析

7.2.1 炬力集成电路设计有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业新产品动向分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.2.2 紫光股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业新产品动向分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.2.3 北京中星微电子有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.2.4 深圳海思半导体有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业新产品动向
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析

7.2.5 中颖电子股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.2.6 北京君正集成电路股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.2.7 上海贝岭股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析

(8) 企业核心竞争力分析

(9) 企业发展优劣势分析

(10) 企业最新发展动向

7.2.8 上海华虹集成电路有限责任公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

(5) 企业技术水平分析

(6) 企业核心竞争力分析

(7) 企业发展优劣势分析

(8) 企业最新发展动向

7.3 集成电路制造企业发展分析

7.3.1 中芯国际集成电路制造有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

(5) 企业新产品动向

(6) 企业营销网络分析

(7) 企业发展优劣势分析

(8) 企业最新发展动向

7.3.2 SK海力士半导体(中国)有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

(5) 企业发展优劣势分析

(6) 企业最新发展动向

7.3.3 和舰科技(苏州)有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

(5) 企业核心竞争力分析

(6) 企业发展优劣势分析

(7) 企业最新发展动向

7.3.4 上海先进半导体制造股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

(5) 企业核心竞争力分析

(6) 企业发展优劣势分析

(7) 企业最新发展动向

7.3.5 台积电（中国）有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

(5) 企业核心竞争力分析

(6) 企业发展优劣势分析

(7) 企业最新发展动向

7.4 集成电路封装测试企业发展分析

7.4.1 日月光封装测试（上海）有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

(5) 企业销售渠道分析

(6) 企业发展优劣势分析

7.4.2 江苏长电科技股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

(7) 企业技术水平分析

(8) 企业核心竞争力分析

(9) 企业发展优劣势分析

(10) 企业最新发展动向

7.4.3 苏州晶方半导体科技股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

(7) 企业技术水平分析

(8) 企业核心竞争力分析

(9) 企业发展优劣势分析

(10) 企业最新发展动向

7.4.4 天水华天科技股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

(7) 企业技术水平分析

(8) 企业核心竞争力分析

(9) 企业发展优劣势分析

(10) 企业最新发展动向

7.4.5 南通富士通微电子股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业目标市场分析

(5) 企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析

(7) 企业技术水平分析

(8) 企业核心竞争力分析

(9) 企业发展优劣势分析

(10) 企业最新发展动向

7.4.6 深圳赛意法微电子有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业发展优劣势分析

7.4.7 上海松下半导体有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业技术水平分析
- (4) 企业销售渠道分析
- (5) 企业发展优劣势分析

7.4.8 英特尔产品（成都）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业发展优劣势分析
- (4) 企业最新发展动向

7.4.9 星科金朋（上海）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业发展优劣势分析
- (6) 企业最新发展动向

7.4.10 英飞凌科技(无锡)有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业发展优劣势分析
- (6) 企业最新发展动向

第八章：集成电路行业投资战略规划与建议

8.1 集成电路行业投资潜力分析

8.1.1 集成电路行业行业投资环境分析

- (1) 行业热点扶持政策分析
- (2) 行业商业模式创新趋势
- 8.1.2 集成电路行业国内外发展水平对比
 - (1) 行业国外发展水平分析
 - (2) 行业国内发展水平分析
 - (3) 行业国内外水平比较分析
- 8.1.3 集成电路行业投资风险
 - (1) 政策风险
 - (2) 宏观经济风险
 - (3) 供求风险
 - (4) 其他风险
- 8.1.4 集成电路行业发展趋势分析
 - (1) 集成电路行业区域发展趋势
 - (2) 集成电路行业技术发展趋势
 - (3) 集成电路行业产品结构趋势
 - (4) 集成电路行业市场竞争趋势
- 8.2 集成电路行业市场前景预测
 - 8.2.1 集成电路行业市场规模预测
 - 8.2.2 集成电路企业经营前景预测
- 8.3 集成电路行业投资前景预测
 - 8.3.1 集成电路行业进入壁垒分析
 - (1) 技术壁垒
 - (2) 人才壁垒
 - (3) 资金实力壁垒
 - (4) 产业化壁垒
 - (5) 客户维护壁垒
 - 8.3.2 集成电路行业发展的影响因素分析
 - (1) 有利因素
 - (2) 不利因素
 - 8.3.3 集成电路行业基本风险特征
 - (1) 行业竞争加剧
 - (2) 供应链产能风险
 - 8.3.4 集成电路行业投资可行性分析
 - (1) 宏观经济环境分析
 - (2) 政策分析

(3) 产业转移

(4) 市场因素

8.3.5 集成电路行业投资前景分析

(1) 行业发展空间较大

(2) 行业政策扶持利好

(3) 下游应用市场增长迅速

(4) 行业目前投资规模偏小

8.4 集成电路行业投资机会与建议

8.4.1 前瞻关于集成电路行业投资热点分析

(1) 集成电路设计业被看好

(2) 网络通信领域依然是核心

(3) 智能家居等市场集成电路需求强劲

(4) 小型化和立体化封装技术具有发展潜力

8.4.2 前瞻关于集成电路行业投资机会分析

8.4.3 前瞻关于集成电路细分市场投资建议

8.4.4 前瞻关于集成电路区域布局投资建议

8.4.5 前瞻关于集成电路企业并购重组建议

图表目录

图表1：集成电路行业代码表

图表2：摩尔定律和计算机芯片发展示意图（单位：个）

图表3：集成电路产业链示意图

图表4：不同尺寸单晶硅片的生命周期示意图（单位：百万平方英寸，年）

图表5：2016-2017年国内电子工业专用设备制造业规模情况（单位：家，亿元，%）

图表6：集成电路行业主要政策分析

图表7：《国家集成电路产业发展推进纲要》主要内容

图表8：2016-2017年中国国内生产总值情况及预测（单位：万亿元，%）

图表9：2016-2017年国内工业增加值增速（单位：亿元，%）

图表10：2016年国内主要宏观经济指标增长率预测（单位：%）

图表11：国内集成电路制造行业销售额与GDP关联分析图（单位：亿元，万亿元）

图表12：2000-2017年国内集成电路行业发明专利申请数量变化图（单位：项）

图表13：2000-2017年集成电路行业专利公开数量变化图（单位：项）

图表14：截至2015年集成电路行业专利申请人（前十名）综合比较（单位：项，%，人，年）

图表15：截至2015年国内集成电路行业发明专利分布领域（前十位）（单位：项）

图表16：2016-2017年美国非农就业人口变化情况（单位：千人）

图表17：2016-2017年美国失业率情况（单位：%）

图表18：2016-2017年美国实际GDP年化季率（单位：%）

图表19：2016-2017年ISM采购经理人指数情况

图表20：2016-2017年欧元区就业和失业情况（单位：千人，%）

图表21：2016-2017年欧元区分季度GDP及增长情况（单位：亿欧元，%）

图表22：2011年以来欧元区政府债务变化情况（单位：%）

图表23：2016-2017年美元/日元汇率

图表24：2016-2017年日本失业率（单位：%）

图表25：2016-2017年日经225指数走势

图表26：2016-2017年日本实际GDP年化季率（单位：%）

图表27：2016-2017年新兴经济体GDP增长情况（单位：%）

图表28：2016-2017年美元与新兴经济体货币汇率变化情况（单位：%）

图表29：2016-2017年全球半导体市场销售额及增速（单位：千美元，%）

图表30：2016-2017年中国集成电路产业发展情况（单位：亿元，亿美元，%）

图表31：2016-2017年国内集成电路产业结构（单位：亿元，%）

图表32：中国集成电路产业长三角地区分布概况

图表33：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析

图表34：2016-2017年国内集成电路设计市场销售收入和增长情况（单位：亿元，%）

图表35：2016-2017年国内集成电路设计业竞争格局变化情况（单位：家）

图表36：集成电路设计业发展策略简析

图表37：2018-2023年国内集成电路设计业市场规模预测（单位：亿元，%）

图表38：集成电路制造行业发展主要特点分析

图表39：2016-2017年国内集成电路制造行业规模分析（单位：家，亿元，%）

图表40：2016-2017年国内集成电路制造行业盈利能力分析（单位：%）

图表41：2016-2017年国内集成电路制造行业运营能力分析（单位：次）

图表42：2016-2017年国内集成电路制造行业偿债能力分析（单位：%、倍）

图表43：2016-2017年中国集成电路制造行业发展能力分析（单位：%）

图表44：2016-2017年国内集成电路制造行业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%）

图表45：2016-2017年国内集成电路制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）

图表46：2016-2017年国内集成电路制造行业产成品余额及增长率走势图（单位：亿元，%）

图表47：2016-2017年国内集成电路制造行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%）

图表48：2016-2017年国内集成电路制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）

- 图表49：2016-2017年国内集成电路制造行业产销率情况（单位：%）
- 图表50：2016-2017年中国集成电路封装测试业市场规模及增长（单位：亿元，%）
- 图表51：国内封测厂商与行业领先封测厂商主要技术对比
- 图表52：五力模型简介
- 图表53：集成电路封装测试业供应商议价能力分析
- 图表54：集成电路封装测试业下游议价能力分析
- 图表55：集成电路封装测试业潜在进入者威胁分析
- 图表56：国内集成电路封装测试业企业竞争力分析
- 图表57：封装技术应用领域发展趋势
- 图表58：2018-2023年国内集成电路封装测试业市场规模预测图（单位：亿元，%）
- 图表59：IC卡行业需求领域分析
- 图表60：国内主要行业IC卡出货量分布情况（单位：%）
- 图表61：2004年以来我国IC卡销售数量变化情况（单位：亿张，%）
- 图表62：国内智能卡行业主要厂商及市场占有率（单位：%）
- 图表63：国内智能卡芯片提供商优势领域
- 图表64：2018-2023年国内IC卡需求量预测（单位：亿张）
- 图表65：2016-2017年国内计算机整机产量及增长情况（单位：万台，%）
- 图表66：2015年国内计算机行业销售产值及增长情况（单位：亿元，%）
- 图表67：2016-2017年国内计算机行业利润增长情况（单位：%）
- 图表68：2015年国内手机累计产量情况（单位：万台，%）
- 图表69：2016-2017年国内智能手机销量（单位：亿部，%）
- 图表70：2014年国内智能手机销量（单位：百万台，%）
- 图表71：2016-2017年全球其他消费类电子产品市场规模及增长（单位：十亿美元，%）
- 图表72：2016-2017年国内数码相机市场品牌关注比例对比（单位，%）
- 图表73：国内数码相机市场影响因素分析
- 图表74：2015年国内平板电视市场品牌关注比例分布（单位，%）
- 图表75：2016-2020年全球可穿戴设备市场规模（单位，百万台）
- 图表76：2014年国内智能手表市场品牌关注比例分布（单位，%）
- 图表77：2015年10月国内智能手环市场品牌关注比例分布（单位，%）
- 图表78：2014年国内MCU应用领域销售额分布（单位：%）
- 图表79：2016-2017年国内MCU市场规模及增长情况（单位：亿元，%）
- 图表80：2014年中国MCU市场品牌销售额结构（单位：%）
- 图表81：2014年国内小家电MCU市场品牌竞争结构（单位：%）
- 图表82：2014年国内鼠标键盘MCU市场品牌竞争结构（单位：%）
- 图表83：2014年国内便携式计算终端用锂电池MCU市场品牌竞争结构（单位：%）

图表84：2014年国内智能电表MCU市场品牌竞争结构（单位：%）

图表85：2018-2023年国内MCU市场规模预测（单位：亿元）

图表86：2016-2017年全球SIM卡出货量情况（单位：亿张，百万张）

图表87：移动支付主要芯片产品

图表88：NFC-SIM产业链

图表89：移动支付芯片制造企业基本情况

图表90：2018-2023年移动支付芯片市场需求规模预测（单位：亿部，亿人，亿元，元，%）

图表91：身份识别技术的分类

图表92：2018-2023年中国金融支付类芯片市场规模预测图（单位：亿颗）

图表93：2013年USBKey芯片市场区域分布（单位：%）

图表94：2010年以来中国通讯射频芯片需求规模走势图（单位：亿元）

图表95：2018-2023年中国通讯射频芯片需求规模预测图（单位：亿元）

图表96：2016-2017年全球通讯基带芯片需求规模走势图（单位：亿美元）

图表97：2016-2017年中国IGBT芯片市场规模走势图（单位：亿元，%）

图表98：2010年以来中国智能电表主控芯片需求规模走势图（单位：亿元，%）

图表99：2010年以来中国锂电池主控芯片需求规模走势图（单位：亿元，%）

图表100：2014年国内IGBT芯片市场份额（单位：%）

图表101：2014年国内便携式计算终端用锂电池控制芯片市场竞争格局（单位：%）

图表102：2014年国内智能电表控制芯片市场竞争格局（单位：%）

图表103：2011年以来中国电脑数码类芯片需求规模走势图（单位：亿元）

图表104：2010年以来中国鼠标芯片需求规模走势图（单位：亿元，%）

图表105：2014年中国鼠标键盘用控制芯片市场竞争格局（单位：%）

图表106：2014年中国MP3用SOC芯片市场竞争格局（单位：%）

图表107：2018-2023年中国电脑数码类芯片需求规模预测（单位：亿元）

图表108：2018-2023年中国鼠标芯片需求规模预测（单位：亿元）

图表109：2015年中国计算机行业季度产值规模走势图（单位：亿元，%）

图表110：2015年中国计算机行业累计出口额及增速情况（单位：亿美元，%）

图表111：2016-2017年中国计算机行业固定资产投资及增长情况（单位：亿元，%）

图表112：2016-2017年中国计算机行业集成电路需求规模（单位：亿元）

图表113：2018-2023年国内计算机行业对集成电路需求规模预测（单位：亿元）

图表114：2015年中国手机行业月度累计产量及增速（单位：万台，%）

图表115：2016-2017年中国智能手机行业市场出货量走势图（单位：亿部）

图表116：2018-2023年智能手机行业对集成电路需求规模预测图（单位：亿元）

图表117：2016-2017年中国可穿戴设备行业市场规模走势图（单位：亿元）

图表118：2016-2017年中国工业控制类集成电路市场规模走势图（单位：亿元，%）

图表119：2018-2023年工业控制行业对集成电路需求规模预测图（单位：亿元）

图表120：2016-2017年中国汽车电子行业市场规模走势图（单位：亿元）

图表121：2010年以来中国汽车电子行业集成电路需求量及占集成电路市场规模的比重（单位：亿元，%）

图表122：中国汽车电子市场主要影响因素分析

图表123：2018-2023年汽车电子行业对集成电路需求规模预测图（单位：亿元）

图表124：2014年我国集成电路行业中外合资企业结构（单位：%）

图表125：2016-2017年通富微电、中颖电子和先进半导体营业收入及增长情况（单位：亿元，%）

图表126：2016-2017年通富微电、中颖电子和先进半导体的净利率走势（单位：%）

图表127：南通富士通微电子股份有限公司对外合作情况

图表128：2016-2017年华天科技、同方国芯和士兰微营业收入及增长情况（单位：亿元，%）

图表129：2016-2017年华天科技、同方国芯和士兰微的净利率走势（单位：%）

图表130：中国内资集成电路企业竞争优势列表

图表131：中国内资集成电路企业劣势列表

图表132：2016-2017年中国集成电路进出口额及逆差情况（单位：亿美元）

图表133：长三角地区集成电路产业发展状况

图表134：长三角地区集成电路产业发展政策或规划

图表135：2016-2017年上海、江苏、浙江集成电路累计产量及增长（单位：亿块，%）

图表136：环渤海地区集成电路产业发展政策或规划

图表137：2016-2017年北京、天津和山东集成电路累计产量及增长（单位：亿块，%）

图表138：深圳IC设计产业在“十三五”期间的发展目标

图表139：2016-2017年广东集成电路累计产量及增长（单位：亿块，%）

图表140：《湖北省集成电路产业发展行动方案》主要内容

图表141：武汉光迅科技股份有限公司发展简况表

图表142：2016-2017年武汉光迅科技股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）

图表143：2016-2017年武汉光迅科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表144：2016-2017年武汉光迅科技股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表145：2016-2017年武汉光迅科技股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）

图表146：2016-2017年武汉光迅科技股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表147：2015上半年武汉光迅科技股份有限公司分产品经营情况（单位：万元，%）

图表148：2015上半年武汉光迅科技股份有限公司分地区经营情况（单位：万元，%）

图表149：武汉光迅科技股份有限公司发展优劣势表

图表150：大唐电信科技股份有限公司发展简况表

图表151：2016-2017年大唐电信科技股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）

图表152：2016-2017年大唐电信科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表153：2016-2017年大唐电信科技股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表154：2016-2017年大唐电信科技股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）

图表155：2016-2017年大唐电信科技股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表156：大唐电信科技股份有限公司产品服务结构表

图表157：大唐电信科技股份有限公司集成电路设计业务情况表

图表158：2015上半年大唐电信科技股份有限公司分产品经营情况（单位：万元、%）

图表159：2015上半年大唐电信科技股份有限公司分地区经营情况（单位：万元、%）

图表160：大唐电信科技股份有限公司发展优劣势表

图表161：恒宝股份有限公司发展简况表

图表162：2016-2017年恒宝股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元、%）

图表163：2016-2017年恒宝股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表164：2016-2017年恒宝股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表165：2016-2017年恒宝股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）

图表166：2016-2017年恒宝股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表167：恒宝股份有限公司产品结构表

图表168：2015上半年恒宝股份有限公司分产品经营情况（单位：万元、%）

图表169：2015上半年恒宝股份有限公司分地区经营情况（单位：万元、%）

图表170：恒宝股份有限公司发展优劣势表

图表171：杭州士兰微电子股份有限公司发展简况表

图表172：2016-2017年杭州士兰微电子股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）

图表173：2016-2017年杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表174：2016-2017年杭州士兰微电子股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表175：2016-2017年杭州士兰微电子股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）

图表176：2016-2017年杭州士兰微电子股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表177：杭州士兰微电子股份有限公司产品结构表

图表178：2015上半年杭州士兰微电子股份有限公司分产品经营情况（单位：万元、%）

图表179：杭州士兰微电子股份有限公司发展优劣势表

图表180：国民技术股份有限公司发展简况表

图表181：2016-2017年国民技术股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）

图表182：2016-2017年国民技术股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表183：2016-2017年国民技术股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表184：2016-2017年国民技术股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）

图表185：2016-2017年国民技术股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表186：国民技术股份有限公司产品结构表

图表187：2015上半年国民技术股份有限公司分产品经营情况（单位：万元，%）

图表188：2015上半年国民技术股份有限公司分地区经营情况（单位：万元，%）

图表189：国民技术股份有限公司发展优劣势表

图表190：珠海欧比特控制工程股份有限公司发展简况表

图表191：2016-2017年珠海欧比特控制工程股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）

图表192：2016-2017年珠海欧比特控制工程股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表193：2016-2017年珠海欧比特控制工程股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表194：2016-2017年珠海欧比特控制工程股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）

图表195：2016-2017年珠海欧比特控制工程股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表196：珠海欧比特控制工程股份有限公司产品结构表

图表197：2015年珠海欧比特控制工程股份有限公司分产品经营情况（单位：万元，%）

图表198：2015年珠海欧比特控制工程股份有限公司分地区经营情况（单位：万元，%）

图表199：珠海欧比特控制工程股份有限公司研发投入情况（单位：万元，%）

图表200：珠海欧比特控制工程股份有限公司发展优劣势表

图表201：同方国芯电子股份有限公司发展简况表

图表202：2016-2017年同方国芯电子股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）

图表203：2016-2017年同方国芯电子股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表204：2016-2017年同方国芯电子股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表205：2016-2017年同方国芯电子股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）

图表206：2016-2017年同方国芯电子股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表207：2015上半年同方国芯电子股份有限公司分产品经营情况（单位：万元，%）

图表208：2015上半年同方国芯电子股份有限公司分地区经营情况（单位：万元，%）

图表209：同方国芯电子股份有限公司发展优劣势表

图表210：无锡华润微电子股份有限公司发展简况表

图表211：无锡华润微电子股份有限公司产品结构表

图表212：无锡华润微电子股份有限公司发展优劣势表

图表213：中国电子信息产业集团有限公司发展简况表

图表214：中国电子信息产业集团有限公司集成电路业务旗下企业情况表

图表215：中国电子信息产业集团有限公司集成电路业务结构表

图表216：中国电子信息产业集团有限公司发展优劣势表

图表217：飞思卡尔半导体（中国）有限公司发展简况表

图表218：飞思卡尔半导体在华经营情况（单位：百万美元，%）

- 图表219：飞思卡尔半导体（中国）有限公司产品结构表
- 图表220：飞思卡尔研发投入情况（单位：百万美元，%）
- 图表221：飞思卡尔半导体（中国）有限公司发展优劣势表
- 图表222：炬力集成电路设计有限公司发展简况表
- 图表223：炬力集成电路设计有限公司经营情况（单位：千美元）
- 图表224：炬力集成电路设计有限公司产品结构表
- 图表225：炬力集成电路设计有限公司研发支出情况（单位：千美元，%）
- 图表226：炬力集成电路设计有限公司发展优劣势表
- 图表227：紫光股份有限公司发展简况表
- 图表228：紫光股份有限公司产品结构表
- 图表229：紫光股份有限公司发展优劣势表
- 图表230：北京中星微电子有限公司发展简况表
- 图表231：2016-2017年北京中星微电子有限公司经营情况（单位：千美元）
- 图表232：北京中星微电子有限公司产品结构图
- 图表233：2016-2017年北京中星微电子有限公司研发支出情况（单位：千美元，%）
- 图表234：北京中星微电子有限公司发展优劣势表
- 图表235：深圳海思半导体有限公司发展简况表
- 图表236：深圳海思半导体有限公司产品结构表
- 图表237：深圳海思半导体有限公司发展优劣势表
- 图表238：中颖电子股份有限公司发展简况表
- 图表239：2016-2017年中颖电子股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）
- 图表240：2016-2017年中颖电子股份有限公司盈利能力分析（单位：%）
- 图表241：2016-2017年中颖电子股份有限公司运营能力分析（单位：次）
- 图表242：2016-2017年中颖电子股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）
- 图表243：2016-2017年中颖电子股份有限公司发展能力分析（单位：%）
- 图表244：中颖电子股份有限公司产品结构表
- 图表245：2015年中颖电子股份有限公司分产品经营情况（单位：万元，%）
- 图表246：2015年中颖电子股份有限公司分地区经营情况（单位：万元，%）
- 图表247：2015年中颖电子股份有限公司新产品动向
- 图表248：中颖电子股份有限公司发展优劣势表
- 图表249：北京君正集成电路股份有限公司发展简况表
- 图表250：2016-2017年北京君正集成电路股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）
- 图表251：2016-2017年北京君正集成电路股份有限公司盈利能力分析（单位：%）
- 图表252：2016-2017年北京君正集成电路股份有限公司运营能力分析（单位：次）
- 图表253：2016-2017年北京君正集成电路股份有限公司偿债能力分析（单位：%）

图表254：2016-2017年北京君正集成电路股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表255：2015上半年北京君正集成电路股份有限公司分行业经营情况（单位：万元，%）

图表256：北京君正集成电路股份有限公司发展优劣势表

图表257：上海贝岭股份有限公司发展简况表

图表258：2016-2017年上海贝岭股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元，%）

图表259：2016-2017年上海贝岭股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表260：2016-2017年上海贝岭股份有限公司偿债能力分析（单位：%）

图表261：2015年上海贝岭股份有限公司分产品经营情况（单位：万元，%）

图表262：2015年上海贝岭股份有限公司分地区经营情况（单位：万元，%）

图表263：上海贝岭股份有限公司发展优劣势表

图表264：上海华虹集成电路有限责任公司发展简况表

图表265：上海华虹集成电路有限责任公司发展优劣势表

图表266：中芯国际集成电路制造有限公司发展简况表

图表267：中芯国际集成电路制造有限公司经营情况（单位：百万美元）

图表268：中芯国际集成电路制造有限公司产品服务结构表

图表269：中芯国际集成电路制造有限公司发展优劣势表

图表270：SK海力士半导体（中国）有限公司发展简况表

图表271：SK海力士在华经营情况（单位：十亿韩元，%）

图表272：SK海力士半导体（中国）有限公司发展优劣势表

图表273：和舰科技（苏州）有限公司发展简况表

图表274：和舰科技（苏州）有限公司发展优劣势表

图表275：上海先进半导体制造股份有限公司发展简况表

图表276：2016-2017年上海先进半导体制造股份有限公司经营情况（单位：千元）

图表277：2015年上海先进半导体制造股份有限公司产品营收占比表（单位：%）

图表278：2015年上海先进半导体制造股份有限公司产品应用领域（单位：%）

图表279：2015年上海先进半导体制造股份有限公司市场区域分布表（单位：%）

图表280：上海先进半导体制造股份有限公司发展优劣势表

图表281：台积电（中国）有限公司发展简况表

图表282：台积电在华经营情况（单位：十亿新台币，%）

图表283：台积电（中国）有限公司发展优劣势表

图表284：日月光封装测试（上海）有限公司发展简况表

图表285：日月光封装测试（上海）有限公司发展优劣势表

图表286：江苏长电科技股份有限公司发展简况表

图表287：2016-2017年江苏长电科技股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）

图表288：2016-2017年江苏长电科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

- 图表289：2016-2017年江苏长电科技股份有限公司运营能力分析（单位：次）
- 图表290：2016-2017年江苏长电科技股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）
- 图表291：2016-2017年江苏长电科技股份有限公司发展能力分析（单位：%）
- 图表292：2015上半年江苏长电科技股份有限公司分产品经营情况（单位：万元、%）
- 图表293：江苏长电科技股份有限公司产品结构表
- 图表294：2015上半年江苏长电科技股份有限公司分地区经营情况（单位：万元、%）
- 图表295：江苏长电科技股份有限公司发展优劣势表
- 图表296：苏州晶方半导体科技股份有限公司发展简况表
- 图表297：2016-2017年苏州晶方半导体科技股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）
- 图表298：2016-2017年苏州晶方半导体科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%）
- 图表299：2016-2017年苏州晶方半导体科技股份有限公司运营能力分析（单位：次）
- 图表300：2016-2017年苏州晶方半导体科技股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）
- 图表301：2016-2017年苏州晶方半导体科技股份有限公司发展能力分析（单位：%）
- 图表302：2015上半年苏州晶方半导体科技股份有限公司分产品经营情况（单位：万元、%）
- 图表303：2015上半年苏州晶方半导体科技股份有限公司分地区经营情况（单位：万元、%）
- 图表304：苏州晶方半导体科技股份有限公司发展优劣势表
- 图表305：天水华天科技股份有限公司发展简况表
- 图表306：2016-2017年天水华天科技股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）
- 图表307：2016-2017年天水华天科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%）
- 图表308：2016-2017年天水华天科技股份有限公司运营能力分析（单位：次）
- 图表309：2016-2017年天水华天科技股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）
- 图表310：2016-2017年天水华天科技股份有限公司发展能力分析（单位：%）
- 图表311：2015年天水华天科技股份有限公司分地区经营情况（单位：万元、%）
- 图表312：天水华天科技股份有限公司发展优劣势表
- 图表313：南通富士通微电子股份有限公司发展简况表
- 图表314：2016-2017年南通富士通微电子股份有限公司主要经营指标分析（单位：万元）
- 图表315：2016-2017年南通富士通微电子股份有限公司盈利能力分析（单位：%）
- 图表316：2016-2017年南通富士通微电子股份有限公司运营能力分析（单位：次）
- 图表317：2016-2017年南通富士通微电子股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）
- 图表318：2016-2017年南通富士通微电子股份有限公司发展能力分析（单位：%）
- 图表319：南通富士通微电子股份有限公司业务结构表
- 图表320：2015上半年南通富士通微电子股份有限公司分产品经营情况（单位：万元、%）

图表321：2015上半年南通富士通微电子股份有限公司分地区经营情况（单位：万元，%）

图表322：南通富士通微电子股份有限公司发展优劣势表

图表323：深圳赛意法微电子有限公司发展简况表

图表324：深圳赛意法微电子有限公司发展优劣势表

图表325：上海松下半导体有限公司发展简况表

图表326：上海松下半导体有限公司发展优劣势表

图表327：英特尔产品（成都）有限公司发展简况表

图表328：英特尔产品（成都）有限公司发展优劣势表

图表329：星科金朋（上海）有限公司发展简况表

图表330：星科金朋（上海）有限公司发展优劣势表

图表331：英飞凌科技(无锡)有限公司发展简况表

图表332：英飞凌科技(无锡)有限公司发展优劣势表

图表333：我国鼓励和支持集成电路产业重要举措

图表334：半导体产业链及业务模式

图表335：垂直分工商业模式

图表336：2014年我国集成电路产业产值结构

图表337：中芯国际工艺制程发展

图表338：2011年以来中国集成电路行业产品结构演变图（单位：%）

图表339：2018-2023年中国集成电路行业市场规模预测图（单位：亿元，%）

图表340：2016-2017年我国集成电路行业投资规模及增速（单位：亿元，%）

图表341：2014年全球集成电路产业产值结构（单位：%）

图表342：2014年我国集成电路产品主要生产区域结构图（单位：%）

图片详见报告正文（GY LX）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，有利于降低企事业单位决策风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/309280309280.html>